

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2026-049

无锡信捷电气股份有限公司

关于购买土地并投资建设项目进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称	具身智能及高端制造核心部件项目
投资金额（亿元）	不低于人民币 20 亿元（含一期项目 8 亿元投资）
投资进展情况	☐ 完成 ☐ 终止 ☒ 交易要素变更
特别风险提示	1、公司本次拟投资建设项目的实施，以取得土地使用权为前提，本次拟投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，公司会根据当地相关部门要求，积极推进项目投资建设实施工作； 2、本次拟投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化、内部管理等内外部因素均存在一定的不确定性，可能存在影响公司投资计划及收益不达预期的风险； 3、本项目资金来源于自有资金或自筹资金。由于本投资项目投资建设存在一定的时间周期，预计不会对公司当期经营业绩构成重大影响，预计对公司未来业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资基本情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于拟购买土地并投资建设项目的议案》，为加快推进公司整体战略目标实现，提高公司整体实力和综合竞争力，公司拟投资 8 亿元人民币建设机器人智能驱控系统生产项目。该项目已于 2026 年 1 月正式开工建设，预计于 2027 年 10 月交付使用。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所官网

(www.sse.com.cn) 的《关于拟购买土地并投资建设项目的公告》（公告编号：2025-035）。

二、本次对外投资进展情况

为进一步加快推进公司整体战略目标实现，提高公司整体实力和综合竞争力，公司于 2026 年 7 月 9 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟签订项目投资意向协议的议案》，拟在前述投资的基础上进一步推进具身智能及高端制造核心部件项目的建设。公司拟与无锡市滨湖区人民政府签订项目投资意向协议，项目总投资不低于人民币 20 亿元（含一期项目 8 亿元投资），分阶段进行投资，具体购买土地及项目建设情况如下：

1、拟投资项目名称：具身智能及高端制造核心部件项目。

2、拟投资金额：不低于人民币 20 亿元（含一期项目 8 亿元投资），具体将根据项目实际进展分阶段投入，最终以项目建设实际投资开支为准。

3、项目前期进展：一期项目已于 2026 年 1 月正式开工建设，预计于 2027 年 10 月交付使用。

4、项目建设地点：无锡市滨湖区

5、项目资金来源：自有资金或自筹资金。

6、项目审议程序：本项目将分阶段实施，投资协议尚未签订。按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，若后续投资方案及协议的实际规模达到董事会、股东会审议标准，公司将按规定提交董事会、股东会审批，并依法履行后续信息披露义务。

本项目投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

1、公司根据自身的战略规划和下游市场发展情况，开展本次项目的投资建设，本次布局的产能是公司主营业务的拓展和延伸。本投资项目投资后如果成功实施，能进一步提升公司的产能，增强公司的综合竞争力和响应市场需求的效率，

符合公司主营业务发展战略，对公司后续发展产生积极影响。

2、公司本次拟投资项目建设投资额较大，资金来源于自有资金或自筹资金，公司将加强资金管理，合理规划资金安排，分阶段推进项目实施。本投资项目中的投资规模等均为计划数或预计数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。

四、对外投资的风险提示

1、公司本次拟投资项目的实施以取得土地使用权为条件，还需就取得土地使用权签订相关协议。因此，土地使用权能否竞得、相关协议能否协商签订，以及最终能否成交、成交面积、价格及取得时间等存在不确定性，若未能购得土地使用权，则拟投资建设项目存在延期、调整或终止的风险。

2、本次拟投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，存在无法取得或无法按时取得相关许可和影响投资计划顺利实施的风险。公司会按照当地相关部门要求，积极推进项目投资建设实施工作。

3、由于本投资项目投资建设存在一定的时间周期，预计不会对公司当期经营业绩构成重大影响，预计对公司未来业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日